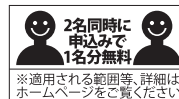


ここ数年の半導体技術のトレンドである「チップレット」に関して、構成パーツのアッセンブリと配線技術への自己組織化プロセスの適用研究を解説。3D-IC、FOWLP、VCSELやμLEDチップの集積・実装についても言及します。



【Live配信(リアルタイム配信)】 自己組織化実装による チップレットのアッセンブリとインターコネクト



日時	2021年8月5日(木) 13:00~16:30	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にいながら学習可能です※
受講料	44,000円 ⇒ テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合: 受講料 定価: 35,200円 / ※E-Mail案内登録価格 33,440円 ※E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。 ※同一企業で複数名E-Mail案内登録されている場合は、本割引ではなく「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。		資料付

講師 東北大学 大学院工学研究科 機械機能創成専攻 准教授 福島誉史 氏

趣旨 More Moore(微細化による性能のスケーリング)、More Than Moore(微細化以外による性能のスケーリング)に続くムーアの法則の第三の方法論として期待されている「チップレット」について解説します。チップレットの集積で鍵となる先端半導体パッケージング(実装)技術の中でアッセンブリとインターコネクト(配線技術)に焦点を当て、液体の表面張力を用いた自己組織化実装技術を取り上げ、従来実装技術と比較してその特徴を述べます。
ポスト5G・人工知能社会のさらなる発展を支えるHPC(High Performance Computing)やMEC(Mobile Edge Computing)で重要となる3D-IC(シリコン貫通配線TSVを用いた三次元積層型集積回路)やFOWLP(Fan-Out Wafer-Level Packaging)に加え、チップレットに含まれる微小なベアダイとして、光電子集積で鍵を握る垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)や次世代ディスプレイで期待されるマイクロLEDチップなどの実装とインターコネクト手法についても紹介します。

プログラム	1. 自己組織化とは 1.1 エレクトロニクスにおける自己組織化 1.1.1 自己組織化単分子膜(SAM)技術 1.1.2 セルフアライメント技術 1.1.3 セルフアライン技術 1.1.4 誘導自己組織化(DSA)技術	3. 自己組織化実装の応用 3.1 チップレットの定義 3.2 チップレットの実装技術の研究動向 3.3 チップレットの自己組織化実装を基盤とした3D-IC/TSV技術 3.4 FOWLPの研究動向と自己組織化実装への期待 3.5 光学素子(VCSEL / LD)の自己組織化実装 3.6 マイクロLEDディスプレイと自己組織化実装
	2. 自己組織化実装の基礎 2.1 原理と駆動力(表面張力の科学) 2.2 動画で分かる自己組織化実装技術の概要 2.3 自己組織化実装の支配因子	4. おわりに <input type="checkbox"/> 質疑応答 <input type="checkbox"/>

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能なか、接続可能なか等をご確認ください。
・セミナー資料は電子ファイルにてダウンロードいただきます。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申し込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の22,000円)

※2名様ともE-Mail案内登録をさせていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B210875 (自己組織化実装) お申し込みには会員の事前登録が必須となります

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	E-Mail案内登録価格を適用いたします。(E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申し込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com